

## 杭州立昂微电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2026 年 1 月 13 日 国信证券、中泰资管、西部利得基金、招银理财、东吴证券、宝隽资产、遂玖资产 2026 年 1 月 15 日 Marshall Wace 2026 年 1 月 16 日 中信证券、建信养老、淡马锡、半夏投资、禹田资本
上市公司接待人员姓名	董事长：王敏文 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云
投资者关系活动记录	<p>董事长王敏文、董事会秘书吴能云就公司的发展历程、主营业务、竞争优势、产业应用、未来发展规划等向与会投资者做了详细的介绍。</p> <p>公司投资者交流的问题回复内容如下：</p> <p>1.公司 12 英寸硅片主要竞争优势是什么？</p> <p>答：公司 12 英寸硅片生产技术拥有自主知识产权，通过二十多年的技术攻关与经验积累，公司外延技术和重掺单晶技术优势突出，是公司的核心竞争力。上述优势可以构建与同行业公司的差异化竞争，因此公司相较同行业公司拥有更好的盈利能力。公司的外延技术既可以应用于重掺硅外延片，也可以应用于轻掺硅外延片。（1）公司拥有行业领先的超低阻重掺单晶技术和外延缺陷消除技术，12 英寸重掺系列外延片满足高端功率器件需求，终端应用于 AI 服务器不间断电源、储能变流器、充电桩、工业电子、伺服驱动器、以及消费类电子、汽车电子、家用电器、嵌入式系统和工业控制等领域，市场需求广阔。现有 12 英寸重掺系列硅片稼动率约 80%。（2）公司轻掺硅外延片聚焦 12 英寸逻辑电路用轻掺硼硅片、BCD 轻掺硼硅片、CIS 轻掺硼硅片等重点产品，上述产品已在客户端快速上量，相较于轻掺抛光片拥有更高的单片价值量。</p> <p>2.公司硅片产品价格趋势如何？是否回到历史高点？</p> <p>答：自 2025 年第一季度以来，公司平均出货价格环比逐季提升。目前硅片产品价格</p>

尚未回到历史高点水平，随着硅片行业和下游相关行业应用的提升，公司平均出货价格有望继续提升。

3.公司 12 英寸硅片设备国产化程度如何？

答：公司大力支持国产设备厂商，公司各尺寸硅片的生产设备均优先采购国产设备，在设备选型中会给予国产设备制造厂商充分的 DEMO 机会，达到要求后会采购。

4.公司功率芯片主要有哪些竞争优势？

答：公司较早通过了大陆、博世、法格的车载体系认证，产品质量稳定。公司功率芯片全部使用公司自己生产的 6 英寸硅外延片，公司可以从硅片材料阶段就给客户做一些定制生产，可以更好地满足客户的需求。

5.公司什么时候开始切入的低轨卫星通讯芯片？

答：立昂东芯 pHEMT 工艺可将栅长 0.15um 的功率管、低噪声晶体管、PN 二极管、E/D 逻辑及射频开关集成于单芯片并实现商业化量产，该工艺于 2023 年完成开发，同年开始进入低轨卫星终端客户，并实现大规模出货。